

2016-2022 年中国集成电路产业现状 深度调查及十三五未来前景预测报 告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016 年

2016-2022 年中国集成电路产业现状深度调查及十三五未来前景预测报告

【报告来源】 [观研网](http://www.proresearch.org/)--<http://www.proresearch.org/>

【关键字】 [投资分析](#) 行业分析 数据研究 行情预测

【出版日期】 2016

【交付方式】 Email 电子版/特快专递

【价 格】 纸介版：7200 元 电子版：7200 元 纸介+电子：7500 元

<http://www.proresearch.org/report/jchdl/201701/190505.html>

《2016-2022 年中国集成电路产业现状深度调查及十三五未来前景预测报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章：中国集成电路行业发展分析

1.1 集成电路行业发展综述

1.1.1 集成电路行业统计标准

1.1.2 集成电路行业周期性

1.1.3 集成电路行业产业链简介

1.1.4 集成电路行业材料供给分析

- (1) 国际硅材料供应现状
- (2) 国内集成电路生产材料供应现状

1.1.5 集成电路生产设备供给分析

- (1) 国内电子工业专用设备制造业运行情况
- (2) 国内集成电路装备制造业状况分析

1.1.6 集成电路行业发展环境分析

- (1) 集成电路行业政策环境分析
- (2) 集成电路行业经济环境分析
- (3) 集成电路行业技术环境分析
- (4) 集成电路行业进出口环境分析

1.2 集成电路行业发展现状分析

1.2.1 全球集成电路行业发展现状

- (1) 行业需求稳健成长
- (2) 全球半导体资本开支开始下降，订单出货比稳定

1.2.2 中国集成电路行业发展现状分析

- (1) 行业经济指标分析
- (2) 行业结构分析
- (3) 行业总体技术水平分析
- (4) 行业总体竞争力分析

1.2.3 集成电路行业区域发展格局分析

- (1) 国内集成电路行业区域发展现状
- (2) 国内集成电路行业整体分布格局
- 1.2.4 集成电路产业面临的发展机遇
- 1.2.5 集成电路行业面临的主要问题
 - (1) 对进口产品仍有较大依赖性
 - (2) 技术能力不强
 - (3) 在产业格局中处于边缘
- 1.3 集成电路设计业发展分析
 - 1.3.1 集成电路设计业发展概况分析
 - 1.3.2 集成电路设计业市场规模分析
 - 1.3.3 集成电路设计业市场特征分析
 - (1) 技术能力大幅提升
 - (2) 行业发展仍存隐忧
 - 1.3.4 集成电路设计业竞争格局分析
 - 1.3.5 集成电路设计业发展策略分析
 - 1.3.6 集成电路设计业发展前景预测
- 1.4 集成电路制造行业发展分析
 - 1.4.1 集成电路制造行业发展现状分析
 - (1) 集成电路制造行业发展总体概况
 - (2) 集成电路制造行业发展主要特点
 - (3) 集成电路制造行业规模及财务指标分析
 - 1.4.2 集成电路制造行业经济指标分析

- (1) 集成电路制造行业主要经济效益影响因素
- (2) 集成电路制造行业经济指标分析
- 1.4.3 集成电路制造行业供需平衡分析
 - (1) 集成电路制造行业供给情况分析
 - (2) 集成电路制造行业需求情况分析
 - (3) 全国集成电路制造行业产销率分析
- 1.4.4 集成电路制造行业发展前景预测
- 1.5 集成电路封装测试业发展分析
 - 1.5.1 集成电路封测业市场规模分析
 - 1.5.2 集成电路封测业经营情况分析
 - 1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析
 - 1.5.4 集成电路封测业竞争格局分析
 - (1) 国内集成电路封测业竞争格局分析
 - (2) 国内集成电路封测企业国际竞争力分析
 - (3) 集成电路封装测试业竞争结构波特五力模型分析
 - 1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析
 - (1) 封装技术发展趋势
 - (2) 应用领域发展趋势
 - 1.5.6 集成电路封测业发展前景预测

第二章：中国集成电路细分产品市场需求分析

2.1 IC 卡市场需求分析

2.1.1 IC 卡市场需求现状分析

2.1.2 IC 卡市场需求规模分析

2.1.3 IC 卡市场竞争格局分析

(1) 市场占有率分析

(2) 各企业竞争优势分析

2.1.4 IC 卡市场需求前景预测

2.2 计算机市场需求分析

2.2.1 计算机市场需求现状分析

2.2.2 计算机市场供给规模分析

2.2.3 计算机市场需求规模分析

2.2.4 计算机市场经营效益分析

2.2.5 计算机市场竞争格局分析

(1) 整体竞争格局分析

(2) 重点企业竞争格局分析

2.2.6 计算机市场发展趋势预测

(1) PC 市场结构调整，用户数量将下降

(2) 智能化趋势提供新的机遇

(3) 游戏本发展迅猛

(4) 国产化替代浪潮加速

2.3 无线通信设备市场需求分析

2.3.1 无线通信设备市场需求现状分析

2.3.2 无线通信设备市场供给规模分析

2.3.3 无线通信设备市场需求规模分析

2.3.4 无线通信设备市场竞争格局分析

2.3.5 无线通信设备市场需求前景预测

(1) 全球市场预测

(2) 国内市场预测

2.4 其他消费类电子产品市场需求分析

2.4.1 其他消费类电子产品需求现状分析

2.4.2 其他消费类电子产品需求规模分析

2.4.3 其他消费类电子产品竞争格局分析

(1) 数码相机竞争格局分析

(2) 平板电视竞争格局分析

(3) 智能穿戴设备竞争格局分析

2.5 微控制单元（MCU）市场需求分析

2.5.1 MCU 市场需求现状分析

2.5.2 MCU 市场需求规模分析

2.5.3 MCU 市场竞争格局分析

(1) MCU 市场整体竞争格局

(2) MCU 细分市场竞争格局

2.5.4 MCU 市场需求前景预测

第三章：中国集成电路芯片市场需求分析

3.1 SIM 芯片市场需求分析

3.1.1 SIM 芯片发展现状分析

3.1.2 SIM 芯片需求规模分析

3.1.3 SIM 芯片竞争格局分析

3.1.4 SIM 芯片需求前景预测

3.2 移动支付芯片市场需求分析

3.2.1 移动支付芯片发展现状分析

- (1) 移动支付产品分析
- (2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决
- (3) 已有大量 POS 机支持 NFC 功能
- (4) 国内供应商开始发力 NFC 芯片

3.2.2 移动支付芯片需求规模分析

3.2.3 移动支付芯片竞争格局分析

3.2.4 移动支付芯片需求前景预测

3.3 身份识别类芯片市场需求分析

3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析

- (1) 身份识别介绍
- (2) 身份识别分类

3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析

3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析

- (1) 国内厂商产能扩大
- (2) 缺乏自主知识产权
- (3) 安全性尚待加强
- (4) 应用尚待开发
- (5) 解决方案仍在探索

(6) 上游产能不足

3.3.4 身份识别类芯片需求前景预测

3.4 金融支付类芯片市场需求分析

3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析

3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析

3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析

3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测

3.5 USB-KEY 芯片市场需求分析

3.5.1 USB-KEY 芯片发展现状分析

3.5.2 USB-KEY 芯片需求规模分析

3.5.3 USB-KEY 芯片竞争格局分析

3.5.4 USB-KEY 芯片需求前景预测

3.6 通讯射频芯片市场需求分析

3.6.1 通讯射频芯片发展现状分析

3.6.2 通讯射频芯片需求规模分析

3.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析

3.6.4 通讯射频芯片需求前景预测

3.7 通讯基带芯片市场需求分析

3.7.1 通讯基带发展现状分析

3.7.2 通讯基带芯片需求规模分析

3.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析

(1) 国际厂商竞争格局分析

(2) 国内厂商竞争格局分析

3.7.4 通讯基带芯片需求前景预测

(1) 基带和应用处理器融合加深

(2) 价格战将加剧

(3) 工艺决定竞争力

3.8 家电控制芯片市场需求分析

3.8.1 家电控制芯片发展现状分析

3.8.2 家电控制芯片需求规模分析

3.8.3 家电控制芯片竞争格局分析

3.8.4 家电控制芯片需求前景预测

3.9 节能应用类芯片市场需求分析

3.9.1 节能应用类芯片发展现状分析

3.9.2 节能应用类芯片需求规模分析

3.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析

3.9.4 节能应用类芯片需求前景预测

3.10 电脑数码类芯片市场需求分析

3.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析

3.10.2 电脑数码类芯片需求规模分析

3.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析

3.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测

第四章：中国集成电路下游市场需求分析

4.1 计算机行业对集成电路需求分析

4.1.1 计算机行业发展现状分析

- (1) 计算机行业产值规模
- (2) 计算机行业外贸出口
- (3) 计算机行业投资情况分析

4.1.2 计算机对集成电路需求分析

4.2 智能手机行业对集成电路需求分析

4.2.1 智能手机行业发展现状分析

4.2.2 智能手机对集成电路需求现状

4.3 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

4.3.1 可穿戴设备行业发展现状分析

4.3.2 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

4.4 工业控制行业对集成电路需求分析

4.4.1 工业控制行业发展现状分析

- (1) 工业机器人发展现状
- (2) 变频器发展现状
- (3) 传感器发展现状
- (4) 工控机发展现状
- (5) 机器视觉发展现状
- (6) 3D 打印发展现状
- (7) 运动控制器发展现状

4.4.2 工业控制对集成电路需求现状

4.5 汽车电子行业对集成电路需求分析

- 4.5.1 汽车电子行业发展现状分析
- 4.5.2 汽车电子对集成电路需求现状
- 4.5.3 汽车电子对集成电路需求前景

第五章：主要集成电路行业竞争主体发展分析

- 5.1 外商独资企业发展分析
 - 5.1.1 外商独资企业发展现状分析
 - 5.1.2 外商独资企业市场份额分析
 - 5.1.3 外商独资企业经营情况分析
 - 5.1.4 外商独资企业投资并购分析
 - 5.1.5 外商独资企业发展战略分析
 - 5.1.6 外商独资企业竞争优势分析
 - 5.1.7 前瞻对外商独资企业发展建议
- 5.2 中外合资企业发展分析
 - 5.2.1 中外合资企业发展现状分析
 - 5.2.2 中外合资企业市场份额分析
 - 5.2.3 中外合资企业经营情况分析
 - 5.2.4 中外合资企业投资并购分析
 - 5.2.5 中外合资企业发展战略分析
 - 5.2.6 中外合资企业竞争优势分析
 - 5.2.7 中外合资企业存在问题分析
 - 5.2.8 中外合资企业最新动向分析
 - 5.2.9 前瞻对中外合资企业发展建议

5.3 内资企业发展分析

5.3.1 内资企业发展现状分析

5.3.2 内资企业市场份额分析

5.3.3 内资企业经营情况分析

5.3.4 内资企业扶持政策分析

5.3.5 内资企业投资并购分析

5.3.6 内资企业发展战略分析

5.3.7 内资企业竞争优势分析

5.3.8 内资企业存在问题分析

5.3.9 内资企业最新动向分析

5.3.10 国内市场进口替代空间分析

5.3.11 前瞻对内资企业发展建议

第六章：重点区域集成电路产业发展分析

6.1 长三角地区集成电路产业发展分析

6.1.1 集成电路产业发展概况

6.1.2 集成电路产业政策规划分析

6.1.3 集成电路设计业发展分析

6.1.4 集成电路制造业发展分析

6.1.5 集成电路封装测试业发展分析

6.1.6 集成电路产业发展前景预测

6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析

6.2.1 集成电路产业发展概况

- 6.2.2 集成电路产业政策规划分析
- 6.2.3 集成电路设计业发展分析
- 6.2.4 集成电路制造业发展分析
- 6.2.5 集成电路封装测试业发展分析
- 6.2.6 集成电路产业发展前景预测
- 6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析
 - 6.3.1 集成电路产业发展概况
 - 6.3.2 集成电路产业政策规划分析
 - 6.3.3 集成电路产业配套发展分析
 - 6.3.4 集成电路设计业发展分析
 - 6.3.5 集成电路制造业发展分析
 - 6.3.6 集成电路封装测试业发展分析
 - 6.3.7 集成电路产业发展前景预测
- 6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析
 - 6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析
 - 6.4.2 四川省集成电路产业发展分析
 - 6.4.3 西安市集成电路产业发展分析
 - 6.4.4 湖北省集成电路产业发展分析

第七章：集成电路领先企业发展分析

- 7.1 集成电路综合型企业发展分析
 - 7.1.1 武汉光迅科技股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业组织架构分析
- (4) 企业产品结构分析
- (5) 企业目标市场分析
- (6) 企业营销网络分析
- (7) 企业新产品动向分析
- (8) 企业技术水平分析
- (9) 企业核心竞争力分析
- (10) 企业发展优劣势分析
- (11) 企业最新发展动向

7.1.2 大唐电信科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业组织与结构分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.3 恒宝股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.4 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.1.5 国民技术股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.6 珠海欧比特控制工程股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.7 同方国芯电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.1.8 无锡华润微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.1.9 中国电子信息产业集团有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析

(6) 企业发展优劣势分析

7.1.10 飞思卡尔半导体（中国）有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业核心竞争力分析

(6) 企业发展优劣势分析

(7) 企业最新发展动向

7.2 集成电路设计企业发展分析

7.2.1 炬力集成电路设计有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业新产品动向分析

(6) 企业技术水平分析

(7) 企业核心竞争力分析

(8) 企业发展优劣势分析

(9) 企业最新发展动向

7.2.2 紫光股份有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业新产品动向分析
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.2.3 北京中星微电子有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.2.4 深圳海思半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业新产品动向
- (6) 企业技术水平分析
- (7) 企业核心竞争力分析
- (8) 企业发展优劣势分析

7.2.5 中颖电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.2.6 北京君正集成电路股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析

- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业发展优劣势分析
- (9) 企业最新发展动向

7.2.7 上海贝岭股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.2.8 上海华虹集成电路有限责任公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业技术水平分析

(6) 企业核心竞争力分析

(7) 企业发展优劣势分析

(8) 企业最新发展动向

7.3 集成电路制造企业发展分析

7.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

(5) 企业新产品动向

(6) 企业营销网络分析

(7) 企业发展优劣势分析

(8) 企业最新发展动向

7.3.2 SK 海力士半导体（中国）有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

(5) 企业发展优劣势分析

(6) 企业最新发展动向

7.3.3 和舰科技（苏州）有限公司发展分析

(1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向

7.3.4 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向

7.3.5 台积电（中国）有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析
- (5) 企业核心竞争力分析
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向

7.4 集成电路封装测试企业发展分析

7.4.1 日月光封装测试（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业销售渠道分析
- (6) 企业发展优劣势分析

7.4.2 江苏长电科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.4.5 南通富士通微电子股份有限公司发展分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业目标市场分析
- (5) 企业营销网络分析
- (6) 企业新产品动向分析
- (7) 企业技术水平分析
- (8) 企业核心竞争力分析
- (9) 企业发展优劣势分析
- (10) 企业最新发展动向

7.4.6 深圳赛意法微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析

7.4.7 上海松下半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业技术水平分析
- (4) 企业销售渠道分析
- (5) 企业发展优劣势分析

7.4.8 英特尔产品（成都）有限公司

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业发展优劣势分析
- (4) 企业最新发展动向

7.4.9 星科金朋（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析
- (6) 企业最新发展动向

7.4.10 英飞凌科技(无锡)有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业目标市场分析
- (4) 企业技术水平分析
- (5) 企业发展优劣势分析
- (6) 企业最新发展动向

第八章：集成电路行业投资战略规划与建议

8.1 集成电路行业投资潜力分析

8.1.1 集成电路行业行业投资环境分析

- (1) 行业热点扶持政策分析
- (2) 行业商业模式创新趋势

8.1.2 集成电路行业国内外发展水平对比

- (1) 行业国外发展水平分析
- (2) 行业国内发展水平分析
- (3) 行业国内外水平比较分析

8.1.3 集成电路行业投资风险

- (1) 政策风险
- (2) 宏观经济风险
- (3) 供求风险
- (4) 其他风险

8.1.4 集成电路行业发展趋势分析

- (1) 集成电路行业区域发展趋势
- (2) 集成电路行业技术发展趋势
- (3) 集成电路行业产品结构趋势
- (4) 集成电路行业市场竞争趋势

8.2 集成电路行业市场前景预测

8.2.1 集成电路行业市场规模预测

8.2.2 集成电路企业经营前景预测

8.3 集成电路行业投资前景预测

8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析

- (1) 技术壁垒
- (2) 人才壁垒
- (3) 资金实力壁垒

(4) 产业化壁垒

(5) 客户维护壁垒

8.3.2 集成电路行业发展的影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

8.3.3 集成电路行业基本风险特征

(1) 行业竞争加剧

(2) 供应链产能风险

8.3.4 集成电路行业投资可行性分析

(1) 宏观经济环境分析

(2) 政策分析

(3) 产业转移

(4) 市场因素

8.3.5 集成电路行业投资前景分析

(1) 行业发展空间较大

(2) 行业政策扶持利好

(3) 下游应用市场增长迅速

(4) 行业目前投资规模偏小

8.4 集成电路行业投资机会与建议

8.4.1 前瞻关于集成电路行业投资热点分析

(1) 集成电路设计业被看好

(2) 网络通信领域依然是核心

(3) 智能家居等市场集成电路需求强劲

(4) 小型化和立体化封装技术具有发展潜力

8.4.2 前瞻关于集成电路行业投资机会分析

8.4.3 前瞻关于集成电路细分市场投资建议

8.4.4 前瞻关于集成电路区域布局投资建议

8.4.5 前瞻关于集成电路企业并购重组建议

图表目录

图表 1：集成电路行业代码表

图表 2：摩尔定律和计算机芯片发展示意图（单位：个）

图表 3：集成电路产业链示意图

图表 4：不同尺寸单晶硅片的生命周期示意图（单位：百万平方英寸，年）

图表 5：2011-2014 年国内电子工业专用设备制造业规模情况（单位：家，亿元，%）

图表 6：集成电路行业主要政策分析

图表 7：《国家集成电路产业发展推进纲要》主要内容

图表 8：2005-2016 年中国国内生产总值情况及预测（单位：万亿元，%）

图表 9：2011-2015 年国内工业增加值增速（单位：亿元，%）

图表 10：2016 年国内主要宏观经济指标增长率预测（单位：%）

图表 11：国内集成电路制造行业销售额与 GDP 关联分析图（单位：亿元，万亿元）

图表 12：2000-2015 年国内集成电路行业发明专利申请数量变化图（单

位：项)

图表 13：2000-2015 年集成电路行业专利公开数量变化图（单位：项）

图表 14：截至 2015 年集成电路行业专利申请人(前十名) 综合比较(单位：项，%，人，年)

图表 15：截至 2015 年国内集成电路行业发明专利分布领域（前十位）
（单位：项）

图表 16：2012-2016 年美国非农就业人口变化情况（单位：千人）

图表 17：2012-2016 年美国失业率情况（单位：%）

图表 18：2012-2015 年美国实际 GDP 年化季率（单位：%）

图表 19：2012-2016 年 ISM 采购经理人指数情况

图表 20：2012-2015 年欧元区就业和失业情况（单位：千人，%）

图表 21：2012-2015 年欧元区分季度 GDP 及增长情况（单位：亿欧元，%）

图表 22：2011 年以来欧元区政府债务变化情况（单位：%）

图表 23：2012-2016 年美元/日元汇率

图表 24：2011-2015 年日本失业率（单位：%）

图表 25：2011-2015 年日经 225 指数走势

图表 26：2012-2015 年日本实际 GDP 年化季率（单位：%）

图表 27：2011-2014 年新兴经济体 GDP 增长情况（单位：%）

图表 28：2011-2015 年美元与新兴经济体货币汇率变化情况(单位：%)

图表 29：2007-2015 年全球半导体市场销售额及增速(单位：千美元，%)

图表 30：2011-2015 年中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465324210310011330>